



Baumit Basic

Zaprawa klejowa do płytek 2–10 mm



- pozwala kleić płytki od góry
- grubość warstwy 2–10 mm
- wodo- i mrozoodporna

Produkt Zaprawa klejowa na bazie szarego cementu. do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Posiada certyfikat EMICODE EC 1 PLUS.

Właściwości Wodo- i mrozoodporna, tiksotropowa, hydraulicznie wiążąca, cienkowarstwowa zaprawa klejowa. Dopuszczona do kontaktu ze środkami spożywczymi.

Przeznaczenie Do przyklejania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych. Do stosowania na podłożach nieodkształcalnych, na wszelkie powierzchnie mineralne o zwykłych wymaganiach, wewnątrz i na zewnątrz budynków, w pomieszczeniach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej.

Dane techniczne

Klasyfikacja:	C1 T wg PN-EN 12004:2002
Czas obróbki:	do 4 godz.
Czas otwarty:	do 20 min.
Czas dojrzewania:	ok. 15 min.
Czas korekty:	do 5 min.
Max. grubość warstwy:	10 mm
Min. grubość warstwy:	2 mm

	Baumit Basic 25 kg
Zużycie	ok. 3 kg/m ² (zależnie od rodzaju płytek)
Zapotrzebowanie wody	ok. 6 l/25 kg

Paca zębata:	3 mm	6 mm	10 mm
Zużycie około:	1,5 kg/m ²	2,5 kg/m ²	3,5 kg/m ²



Opakowanie Worek 25 kg, 42 wor./pal. = 1050 kg

Przechowywanie W suchym i chłodnym miejscu, na paletach drewnianych, przez okres 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku.

Gwarancja jakości Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.

Bezpieczeństwo Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31) dostępną na żądanie klienta lub na stronie www.baumit.pl

Podłoże	Podłoże musi być czyste, suche, nieprzemarznięte, odpylone i odtłuszczone, wolne od wykwitów, nośne i pozbawione luźnych cząstek. Zaprawę można stosować na: beton, jastrych, gazobeton, klinkier, gotowe tynki cementowe i gipsowe, kartonowe płyty gipsowe, gipsowe ścienne płyty budowlane, jastrychy anhydrytowe (odpowiednio zagruntowane). Nie stosować na: drewno, metal, tworzywa sztuczne, podłoża na bazie cementu przed zakończeniem procesów wiązania oraz w obrębie tarasów, elewacji, basenów kąpielowych i ogrzewania podłogowego.
Przygotowanie podłoża	Podłoże oczyścić z pyłu, kurzu oraz zagruntować odpowiednim preparatem : w przypadku podłoży chłonnych - Baunit Grund, w przypadku podłoży niechłonnych - Baunit SuperPrimer.
Obróbka	<p>Zalecane narzędzia: Wolnoobrotowe mieszadło elektryczne, paca zębata, kielnia, gąbka paca 3 x 3 mm - klejenie mozaiki paca 6 x 6 mm - klejenie płytek o spodzie gładkim paca 10 x 10 mm - klejenie płytek o spodzie profilowanym</p> <p>Wysypać zawartość worka do odpowiedniej ilości czystej wody i mieszać przez ok. 3 min. czystym, wolnoobrotowym mieszadłem do uzyskania jednorodnej masy. Po ok. 15 min. ponownie, krótko przemieszać zaprawę.</p> <p>Używając odpowiedniej pacy zębatej, nanosić zaprawę klejową równomiernie na podłoże (pacę utrzymywać podczas rozprowadzania materiału pod kątem 45 stopni do podłoża). Kleić wyłącznie świeżą zaprawą, ewentualne jej pozostałości usuwać zwilżoną gąbką.</p> <p>Zalecane pokrycie spodu płytki klejem (wypełnienie przestrzeni podpłytkowej):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ wewnątrz budynków > 65% ■ na zewnątrz budynków > 90% <p>Zapewnienie pełnego kontaktu płytki z klejem można otrzymać poprzez układanie płytek metodą kombinowaną (BUTTERING – FLOATING), polegającą na nanoszeniu zaprawy klejowej zarówno na podłoże jak i na spód płytki.</p> <p>Przez ok. 48 godzin chronić klejoną powierzchnię przed obciążeniami mechanicznymi i termicznymi (nie chodzić i nie obciążać ułożonych płytek).</p>
Wskazówki	<p>Przestrzegać norm, wytycznych i innych informacji technicznych dotyczących podłoża i okładzin.</p> <p>Nie stosować w temperaturze poniżej + 5 °C lub powyżej +25 °C, w deszczu, przy bezpośrednim nasłonecznieniu, silnym wietrze lub przeciągach. Chronić do czasu pełnego utwardzenia.</p> <p>Wysoka wilgotność powietrza i niskie temperatury wydłużają przewidziany czas schnięcia, wysokie temperatury skracają czas wiązania i utwardzania!</p> <p>Nie dodawać żadnych innych materiałów!</p> <p>Nie moczyć ani podłoża ani płytek.</p> <p>Bezwzględnie przestrzegać podanego czasu otwartego - schnięcia naniesionej na podłoże zaprawy klejowej. Po przekroczeniu tego czasu zaprawę należy usunąć.</p>

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniają one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze „Ogólne warunki umów” znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego Przedstawiciela Handlowego.